

一般不受管制的
集成電路、電子零件和裝備

《進出口（戰略物品）規例》經《2004年進出口（戰略物品）規例（修訂附表1）令》修訂後，對下列集成電路、電子零件和裝備，在一般情況下都不會施加進／出口簽證管制，除非其用作與核子、化學或生物武器或能發射該等武器的導彈有關的用途－

- (A) 電子零件，例如：低能量儲存電容器、電阻、二極管、半導體開關元件和微波電晶體管，其操作頻率不超逾 3.2 千兆赫等

- (B) 下列並非設計成或評定為能抵受輻射的集成電路：
（注意：本部分所述的集成電路，其操作周圍溫度並無限制。）
 - (1) 下列操作頻率不超逾 3 千兆赫的功率放大器集成電路：
 - (a) 運算放大器
 - (b) 隔離放大器
 - (c) 測量放大器
 - (d) 音頻放大器

 - (2) 下列電壓集成電路：
 - (a) 電壓比較器
 - (b) 電壓標準器具
 - (c) 電壓調節器

 - (3) 下列並非由化合物半導體製造的儲存集成電路：
 - (a) 動態隨機存取記憶體(DRAM)，包括快速頁隨機存取記憶體(Fast Page RAM)、擴充數據輸出隨機存取記憶體(EDO-RAM)、同步動態隨機存取記憶體(SDRAM)，以及同步繪圖隨機存取記憶體(SGRAM)
 - (b) 未程式的紫外光可清除可程式唯讀記憶體(UV-EPROM)

 - (4) 74 系列、54 系列和 4000 系列中的邏輯集成電路

- (5) 為應用於民用汽車電子設備而設計或編排程式的集成電路（例如：應用於娛樂、測量、安全、舒適、操作或污染）
 - (6) 為應用於家庭電子設備而設計或編排程式的集成電路（例如：應用於影音設備、用具、安全、教育、舒適、遙控玩具或娛樂）
 - (7) 為應用於計時設備而設計或編排程式的集成電路（例如：應用於錶、鐘）
- (C) 下列並非設計成或評定為能抵受輻射，以及並非評定為可在周圍溫度攝氏-55度以下、攝氏125度以上，或攝氏-55度至攝氏125度整個範圍內操作的硅基集成電路：
- (1) 下列的微處理器集成電路：
 - (a) 英特爾(Intel)處理器，例如 Celeron、Celeron M、Pentium III、Pentium III M、Pentium III Xeon、Pentium 4、Pentium M、Itanium、Itanium 2 和 Xeon 等，不論時鐘頻率為何
 - (b) AMD 處理器，例如 Duron、Athlon 4、Athlon MP、Athlon XP、Athlon XP-M 等，不論時鐘頻率為何（Opteron 除外，該等處理器仍受管制）
 - (c) 摩托羅拉(Motorola)處理器〔安全處理器除外，該類處理器應根據密碼功能作評估〕
 - (d) PowerPC G3、G4 和 G5，不論時鐘頻率為何
 - (2) 下列並非由化合物半導體製造的儲存集成電路：
 - (a) 未程式的電清除可程式唯讀記憶體(EEPROM)
 - (b) 快閃記憶體
 - (c) 靜態隨機存取記憶體(SRAM)
 - (3) 下列的模擬－數字轉換器集成電路：
 - (a) 解析度少於 8 位元

- (b) 解析度為 8 位元或以上，但少於 12 位元，而轉換時間為 5 毫微秒或以上
 - (c) 解析度為 12 位元，轉換時間為 20 毫微秒或以上
 - (d) 解析度為 12 位元以上，但少於或等於 14 位元，而轉換時間為 200 毫微秒或以上
 - (e) 解析度超過 14 位元，轉換時間為 1 微秒或以上
- (4) 符合下列標準的數字－模擬轉換器集成電路：
- (a) 解析度少於 12 位元；或
 - (b) 定時間為 10 毫微秒或以上
- (5) 具有下列各項特性的可場程式邏輯裝置：
- (a) 30 000 或以下等效可用閘數（2 個輸入閘）
 - (b) 典型的基本閘傳遞延遲時間為 0.1 毫微秒或以上；或
 - (c) 觸發頻率為 133 兆赫或以下
- (D) 特別設計用於電訊裝備的零件、集成電路或模組，例如用於調頻／調幅(FM/AM)收音機的集成電路、集成通訊微處理器、數字式高速通訊用雷射器模組、數字式用戶線路收發器，以及使用於廣域網絡、區域網絡、非同步式輸送模式(ATM)、T1、T3、E1、E3 或非對稱數字用戶線路(ADSL)標準中的通訊控制器
- (E) 一般用途電子裝備：
- (1) 為民用電視應用而特別設計用作電視錄像的數字影像磁帶錄像機器
 - (2) 操作頻率為 31.8 千兆赫或以下的射頻訊號分析器
 - (3) 典型的頻率合成訊號產生器，最大合成頻率為 31.8 千兆赫或以下
 - (4) 最大操作頻率為 43.5 千兆赫或以下的網絡分析儀

(5) 最大操作頻率為 43.5 千兆赫或以下的微波測試接收器

- 註： 1. 上述清單不包括光或光敏集成電路和其電子零件。
2. 上述清單包括完成裝殼的集成電路和未覆蓋的晶粒。未覆蓋的晶粒必須有一個固定的圖形，並已有確定的功能。

注意： 上述清單並非詳盡無遺，不應視作正式的分類指示。出口商如欲得知詳細的資料，請參閱上述的附表。如有關物品是特別設計或改裝以作軍事、核子或航天用途，或用於其他受附 1 管制的戰略物品，上述清單將不適用。

工業貿易署
2006 年 4 月 (修訂版 1)